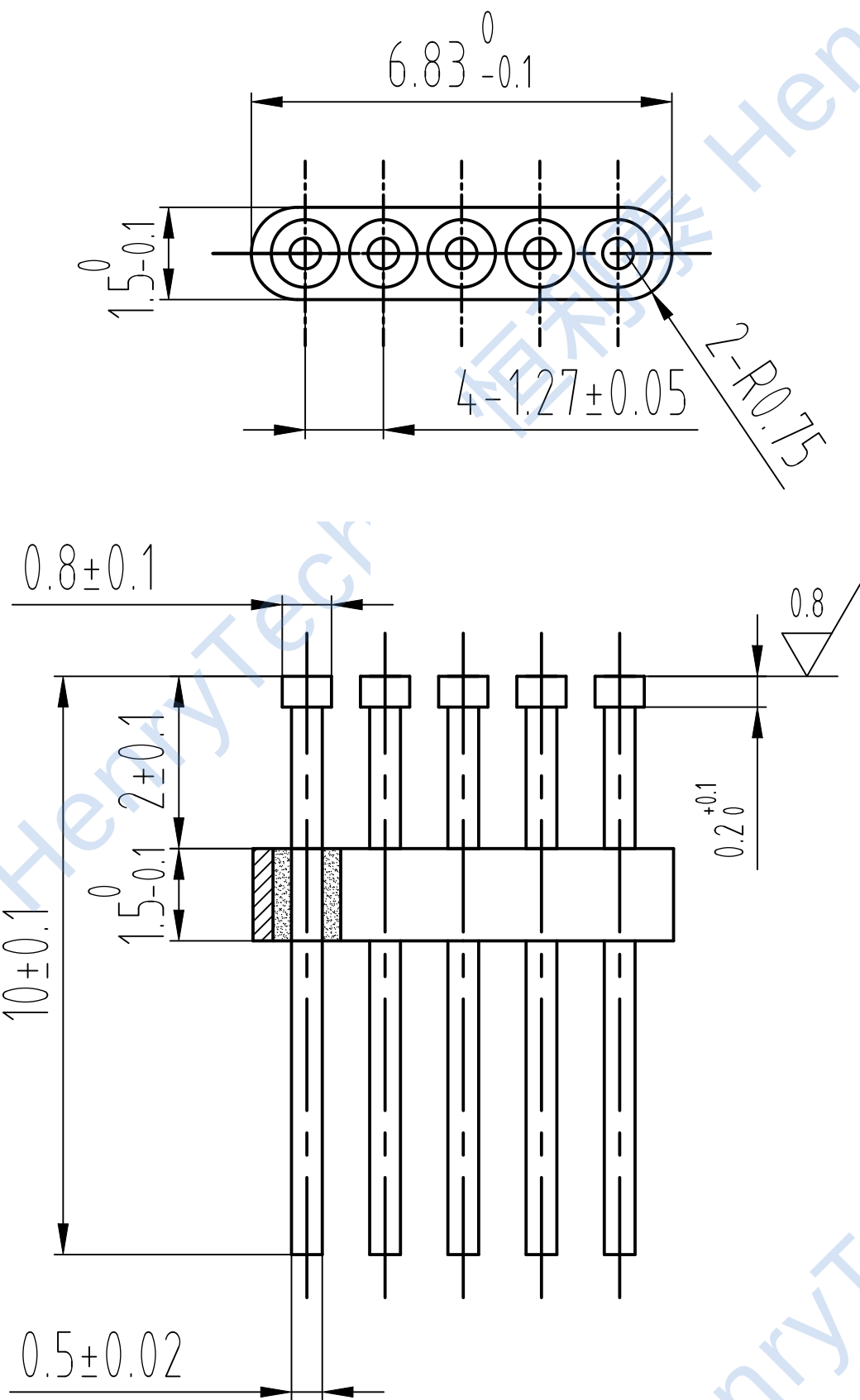




- 技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3 / S$
 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 5. 温度范围： $-65 \sim +155$
 6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu m$ 软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

					装配图				HN-LP5-0.5-1.27(10-2)-T0.8	
									成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号		签字	日期					成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
设计	M。		标准化			图样标记		重量	比例	
									7:1	
审核										
工艺			日期			共 页		第 页		